第14回マイクロエレクトロニクスショー報告

今田 悟*

Report of the 14th Microelectronics Show

Satoru IMADA*

*マイクロエレクトロニクスショー実行委員会委員長、株式会社エヌエフ回路設計ブロック/NF CORPORATION

1. 総括

第14回マイクロエレクトロニクスショーが2000年4月19日（水）から21日（金）までの3日間、大宮ソニックシティで開催されました。今回も、国際会議IEMT/IMCシンポジウムとの同時開催ということもあり、国内外から多数の来場者でにぎわいました。

シンポジウムにおいてCSP、BGAなどのパッケージング技術を始め、微細接続、光モジュール、Pbフリー、放熱技術ほか最先端研究論文78編（他に招待講演4編）が世界11カ国より発表されるかわら、当ショーにおいては、66社の参画を得て「実装技術の新ミレニアムを拓く先端実装技術、基板、部品、材料、装置の総合技術展」というテーマで中身の濃い展示・情報の発信が行われました。

ショーの本旨である国内外の第一線のマイクロエレクトロニクス技術者に対する最先端情報の提供と、ホットな情報交流を通じた新マーケットの創出あるいは商談の場として、皆さまには大いにご活用いただけたものと確信しております。

次世代新実装技術に寄せられている熱意ある関心は、曇り、ないし雨という天候不順ながら過去最高の来場者数、16,683名で裏付けられました。

恒例となっております「製品技術説明会」は34社、3,496名の総聴講者数を記録しました。昨年好評をいただいた「特別

講演」は内容をさらに充実し、最新の情報の啓蒙活動も行いました。

また、初日に行われたIEMT/IMCブニングパーティーも国際色豊かに、同業者あるいは官学関係者同士、和やかなコミュニケーションが図られ、当ショーの盛況ぶりが再認識されたことと存じます。

今回も行われました“もれなく当たる抽選会”も大変好評を得、可能な限り今後も継承して行く所存です。

来年、21世紀の幕開けとなる2001年（第15回マイクロエレクトロニクスショー）は、ついに都心部に進出し「TRC東京流通センターアールN展示場」で行うことが決定しております。これまでより広がった会場で、さらに有意義な展示会に発展できるよう展示委員一同努力してまいりますので、出展社、来場の皆さまのご理解とご協力を引き続きお願い申し上げます。

2. 展示会実績

(1)出展社数

経済状況の厳しい中、昨年に比べ7社少ない66社（情報・大学関係を含む）の参画を得ることができ、ひとえに出展社ならびに関係各位の熱意に感謝いたします。

○A展示	: 33社	51小間
○B展示	: 28社	29小間
○情報・大学コーナー	: 5団体	

(2)出展内容

最先端実装技術を支える部品、材料、装置がそれぞれ独自性を保ちながら、単なるデバイス・部品に特化するのみならずシステム化されるなど、PDP実装やLTCC、半導体パッケージングなどエコロジーにも配慮した広範な製品、技術が展示され守備範囲も拡大しました。

(3)来場者数

全般的に天候不順ながら過去最高の16,683名（前年比307名増）の来場者数を数えました。出展社側からも来場者数が多く、密度の濃い問い合わせが多かったと好評でした。

3. 製品技術説明会実績

(1)製品技術説明会

内容を充実させながら7回目の実施となりました。発表件数・総聴講者数は過去最高の昨年実績には若干及びみせんでしたが、予稿集の販売は過去最高となりました。例年と同様にフリップチップ・ACF関連の説明会では、150名を越える聴講者で会場がぎゅうぎゅう詰めになるほどで、それぞれ持ち時間の25分をフル活用され熱のこもった講演と質疑で終始しました。

①発表件（会社）数	: 34件
②聴講者数	: 3,496名
③平均聴講者数	: 103名
④発表内容	: 高密度実装用材料および装置、BGA&CSP実装技術・基板、半導体封止材、導電・絶縁ペースト、パッケージング治具・加工機

(2)特別講演

昨年に引き続き特別講演を会期中1日1回行いました。各界からの最先端の講演は延べ500名近い聴講者があり、熱心な質疑応答にも支えられ好評を博しました。

1日目：「最近の実装技術の広がり」
傳田精一（JIEP前理事/信

マイクロエレクトロニクスショー会場

特別講演の傳田精一氏

州大学)
2日目:「エレクトロニクス実装
における戦略的エコデザ
インの推進」
林 秀臣 (JIEP前理事/フ
ジクラ)
3日目:「2010年のエレクトロニク
ス実装技術ロードマップ
(JIEP)」

宮代文夫 (JIEP副会長/東
芝ケミカル)

4. 今後の発展に向けて

当マイクロエレクトロニクスショー
は、独立した展示会としてスタートして
から7回目を数えました。関係各位の熱
意と努力により、米国、ECにおける
IMAPSと並ぶ規模に育ち、最先端の高

密度実装技術ではむしろ凌駕、リードす
るまでに発展しました。この間、大宮ソ
ニックシティで開催してまいりましたが、
会場の狭さ、2ヶ所に別れているため
のわかりにくさといった懸案事項を解
消し、さらなる発展を図るべく来年は都
心部に進出をし「TRC東京流通センター
アールンE展示場」で開催されます。専
門技術者を対象とした専門展示会とい
うことで、単に来場者数を他の展示会と
比較できるものではありませんが、来場者
および出展社のレベルの高い展示会で
す。内容の充実はもちろんのこと、親し
まれ信頼される展示会としてより広範な
出展参画が得られますよう、関係各位の
暖かいご理解とご支援をお願いするもの
です。

最後に、展示運営にご苦勞いただいた
スペースメディアジャパン、およびフジ
ヤの皆さまに感謝の意を表します。

書評

THE Japanese ELECTRONICS INDUSTRY

・ Wataru Nakayama, William Boulton and Michael Pecht 著
・ CHAPMAN & HALL/CRC
・ 定価: \$ 44.95

杉本 泰博 (中央大学)

本書は6章からなる。第1章は日本の紹介の章であり、
宗教、教育、歴史、政府組織等について述べている。第2
章では経済状況を述べており、海外との貿易状況、輸出入
振興策、規制緩和の状況、米国との関係等の記述がある。
第3章は日本の電子産業の歴史をふりかえり、特に政府主
導型の開発の経緯を詳しく述べている。第4章では今日の
日本の電子産業の状況を分析している。日本が電子装置の
軽薄短小化という点で強みを発揮し世界をリードしている
こと、この軽薄短小化を達成するためパッケージ技術を含
め関連技術に注力し、すばらしいアイデアを多く輩出して
いること、将来の電子機器の開発に向けてのシナリオ等の
記述がある。第5章は研究、開発、教育について述べた章
である。特に企業と政府が共同して研究開発を進めている
プロジェクトを詳細に紹介している。また大学の役割につ
いても言及している。最後に電子装置の小型化の将来展望、
日本が描いている小型化に対する将来の目標および21世紀
のパッケージ技術についての記述がある。第6章は終章で
ある。

全体として個々の分析は緻密で正しい。例えば日本の電
子産業に携わる各社のこれまでの姿勢は、主に生産品質と

歩留まりの向上であったこと、政府においてもこの正確に
品質を制御するための研究、開発を援助してきたこと、等
思い当たることも多い。また日本の将来方向として、民生
分野で培った軽薄短小化技術を発展させて世界をリードす
ることを勧めている。この際、パッケージ技術と各種部品
技術が鍵を握るであろうということなど、的確な分析であ
り、この意味でわれわれの過去、将来の方向をはっきりと
再認識したいという方には良書であると思える。

ただ外国人(著者に日本人も含まれているが)から見て、
政府の必要以上の関与は気になるらしく、この点を強調し
た記述が多くある。また日本人の国民性にも言及した部分
が多くあり、日本人は会社の上司の評価を気にしながら仕
事をやっているとか、新しいアイデアを導入しようとして
アメリカの教授を訪ねる場合などほとんど土産(資金提供
の意味)なしであり、アイデアなどを尊重しようとする風
潮はない、等々ややヒステリックに批判しているような部
分も見受けられる。

本文は英語で書かれているが、結構むずかしい文章とな
っている、読むには骨がおれるかもしれない。